

第4回

3次元積層 半導体量子イメージセンサ 研究会

KEK

AIST

東京大学

筑波大学

参加費
無料
定員 150名

2020.1.27 (月) 13:30-17:30

会場：つくば国際会議場（大会議室 102 室）

参加申込



会場準備の都合上、できるだけ事前申込みをお願いします。
詳細はサイトをご覧ください。
http://rd.kek.jp/project/soi/TIA20/2001_TIA3D.html

お問合せ

高エネルギー加速器研究機構(KEK)
先端加速器推進部
倉知郁生 mail: kurachii@post.kek.jp

招待講演

「SABを使用した
高精度アライメント接合方法及び装置」
ボンドテック(株) 山内 朗

「3次元積層のための表面活性化常温接合」
明星大学 須賀 唯知

「低温接合技術に基づく異種材料集積技術と
センサ・マイクロシステム応用」
産総研 日暮 栄治

一般講演

倉知 郁生 (KEK)
藤野 真久 (産総研)
原 和彦 (筑波大学)

主催：TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」: '3次元積層半導体量子イメージセンサの調査研究'グループ
(高エネルギー加速器研究機構、産業技術総合研究所、東京大学、筑波大学)

後援：TIA, TIA 光子計測マネジメント・グループ、SOI量子イメージセンサコンソーシアム





第4回

3次元積層半導体量子イメージセンサ研究会

program

13:30 はじめに :TIA かけはし 3D 活動 4 年を振り返って

高エネルギー加速器研究機構 倉知 郁生

一般講演

13:50 素粒子実験用 SOFIST ピクセルセンサーの 3D 積層

筑波大学 原 和彦

14:25 3次元実装におけるウエハレベルハイブリッドボンディング

産業技術総合研究所 藤野 真久

招待講演

15:00 SAB を使用した高精度アライメント接合方法及び装置

ボンドテック(株) 山内 朗

15:35 Break

15:55 3次元積層のための表面活性化常温接合

明星大学 須賀 唯知

16:30 低温接合技術に基づく異種材料集積技術とセンサ・マイクロシステム応用

産業技術総合研究所 日暮 栄治

17:05 ディスカッション

高エネルギー加速器研究機構 倉知 郁生

17:25 まとめ

高エネルギー加速器研究機構 新井 康夫

<p>会場</p> <p>つくば国際会議場 (エポカルつくば) 〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3 URL : http://www.epochal.or.jp/</p> <p>アクセス</p> <p>つくばエクスプレス つくば駅より徒歩 10 分 会場周辺に有料駐車場あり http://www.epochal.or.jp/access/index.html</p>	
--	--